

導入案件

產品開發領域



■ = 用途

— = 特徴

客製膠罐



耐熱規格

金屬膠罐

[1] × [A+B+J]

通信裝置零件



小孔徑穩定量產

調光零件

[1] × [A+B]

醫療用零件



鈦細微加工

微針

[8] × [A]

「Let's do this」 精密加工技術目錄

將您的 構思實體化的 製造業

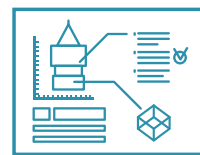
捷科泰亞的座右銘是「透過加工技術顛覆產業界的常識」。我們的核心技術是精密加工技術和鑽石加工技術，除了繼續挑戰既有產品的創新，也跳脫現有框架，在通信、醫療保健、宇宙開發等各行業提供不同的商品。

研發和量產的一貫化專業服務

從提案到量產，捷科泰亞的「一貫化專業服務」可提供成本低，交期快的服務。

傾聽 · 提案

從簡單的加工到新產品的開發，請告訴我們您所需的材料，形狀，數量等要求。我們將用我們獨特的技術為您提案。



開發 · 試做

利用各種材料的加工經驗和技術，提供最合適的加工方法，甚至做到比圖面上更高的精準度。



評估 · 修正

在客戶的評估得到反饋後，我司業務部、工程部及品質保證部將共同研討進一步的修正，經過不斷的評估及改善，以便創造更好的產品。



量產

我們會在位於菲律賓宿霧的內部工廠進行大規模生產，從小批量到大量生產，我們以低價響應。即使大量生產後，我們也將不斷的進行工程改善。



加工技術一覽

設備	技術			材料
綜合加工機	微細孔加工	極小孔加工	φ0.030 mm (最長: 2.5 D)	SUS303
		小孔洞加工	φ0.030 ~ φ0.090 mm (標準: 10 D)	
	一般孔洞加工	鑽孔加工	φ0.10 ~ φ12.0 mm	SUS、鋼鐵、POM*、Ti、Al等
		擴孔加工	φ2.0 ~ φ12.0 mm	
		攻牙加工	M3 ~ M12	
立銑刀加工	外徑加工	φ0.080 mm ± 0.005 mm	SUS303	
車床機	微細孔加工	極小孔加工	φ0.030 ~ φ0.090 mm	SUS303
		鑽孔加工	φ0.10 ~ φ0.90 mm	SUS、鋼鐵、POM*、Ti、Al等
	一般孔洞加工	孔洞加工	φ1.0 mm ~	SUS、鋼鐵、POM*、Ti、Al等
		擴孔加工	φ3.0 mm ~	
		攻牙加工	M3 ~ M10	
	細微加工	外圓車削加工	φ0.20 mm ± 0.02 mm (最長: 5.5D)	SUS303
磨床機	外圍加工	錐銷	15° ~	SUS304、鎢鋼、鋼鐵、黃銅、HSS、TY-100** 等
		先端R角加工	R = 0.010 mm ± 0.005 mm	
	自製加工治具	錐銷	15° ~	
		圓柱外徑加工	φ1.0 ~ φ10 mm ± 0.003 mm	
剪床機	切斷加工	-	鑽石、藍寶石、石英等	
拋光機	拋光加工	▽▽▽FL	SUS303、HPM38、紅寶石	

加工 / 處理	技術		材料	
表面處理、熱處理等	增加撥水性	撥水塗層	SUS、鋼鐵	
	其他機能	淬火	HPM38	
氣體軟氮化				
接合加工	環氧膠	POM* + 金屬、或 金屬 + 金屬	SUS、鎢鋼、POM*	
	焊接	YAG雷射 點焊	SUS	
	釐焊	鑽石 + 金屬 釐焊	鑽石、鎢鋼、鋼鐵	
	陶瓷接合	-	鑽石、石英	
	嵌縫	-	SUS	
	收縮接合	紅寶石 + 金屬接合	SUS、紅寶石、鎢鋼、鋼鐵	
壓裝加工	-	SUS		
鑽石研磨	錐度加工	圓錐加工	銳角方向60°、先端平面5 μm	鑽石
		四角錐加工	先端誤差: < 1 μm	
		三角錐加工	R = < 0.1 μm (100 nm)	
	先端加工	先端R角加工	R = 10 μm ~ 1.0 mm	
		銳角加工	40°	
	周邊加工	薄板加工	t = 50 μm	
方柱加工		□100 μm 或之上		

POM* = 聚甲醛
TY-100** = Au - Pt - Pd - Ag系合金

[材料] 和 [加工技術] 的加乘效果 用原創產品實現您的想法

我們用各式精密加工技術提供各種產品。由材料和技術的結合，讓開發產品的潛力**無限大**。
我們同時也對應專屬您的客製品。

材料

1 SUS303 2 SUS304 3 **紅寶石** 4 **鑽石** 5 TY-100 6 HSS 7 **鎢鋼** 8 其他

技術

A 細微加工 B 微細孔加工 C 拋光加工 D 自製加工治具 E 嵌縫加工 F 收縮接合 G 鑽石研磨加工 H 鈎焊、接着 (金屬 + 鑽石、金屬 + 金屬) I 細微車削加工 J 壓裝加工

導入案件

產品開發領域 ∞

<p>用途</p> <p>汽車零件・水晶元件・LED・VCM音圈馬達 航空宇宙開發・醫療測試用藥</p> <p>特徵</p> <p>不爬膠 不阻塞 不大小滴</p> <p>精密點膠針</p> <p>$[1 \text{ or } 8] \times [A + B + C + D]$</p>	<p>3D生物材料列印</p> <p>超精密點膠針</p> <p>$[1] \times [A + B + C + D]$</p>	<p>3D列印</p> <p>難切削材料的高精度加工 可對應小內徑</p> <p>3D列印用點膠針</p> <p>$[1 \text{ or } 8] \times [A + B + C + D]$</p>	<p>鏡頭模組組裝</p> <p>先端長度是內徑的24倍 可塗布狹小範圍 避開干涉物</p> <p>先端超長針頭</p> <p>$[1] \times [A + B + C + D]$</p>	<p>液晶面板組裝</p> <p>特殊形狀</p> <p>JET噴嘴</p> <p>$[1 \text{ or } 8] \times [A + B + C + D]$</p>	<p>半導體組裝</p> <p>不會有針管掉落 下沉等問題</p> <p>多嘴型點膠針</p> <p>$[1] \times [A + B + E]$</p>
<p>液晶面板組裝</p> <p>先端耐磨耗</p> <p>紅寶石針頭</p> <p>$[1 + 3] \times [A + B + F]$</p>	<p>GaN/SiC等晶片切割</p> <p>乾式切割 提升集積率 控制暗裂</p> <p>鑽石切割刀</p> <p>$[1 + 4] \times [A + G + H]$</p>	<p>研究開發用手動切割刀</p> <p>簡單・低價</p> <p>手動切割刀</p> <p>$[1 + 4] \times [A + G + H]$</p>	<p>硬度測試</p> <p>對應各種規格</p> <p>鑽石壓頭</p> <p>$[1 + 4] \times [A + G + H]$</p>	<p>水晶振盪器晶片搬運</p> <p>壽命長</p> <p>鑽石夾具</p> <p>$[1 + 4] \times [A + H]$</p>	<p>半導體晶片脫離</p> <p>壽命長</p> <p>鑽石頂針</p> <p>$[1 + 4] \times [A + G + H + I]$</p>
					<p>半導體檢測</p> <p>量產無落差</p> <p>頂針</p> <p>$[2 \text{ or } 5 \text{ or } 6 \text{ or } 7] \times [I]$</p>

Continue!